

03/12/02
2002079791

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2002 年 10 月 24 日 (24.10.2002)

PCT

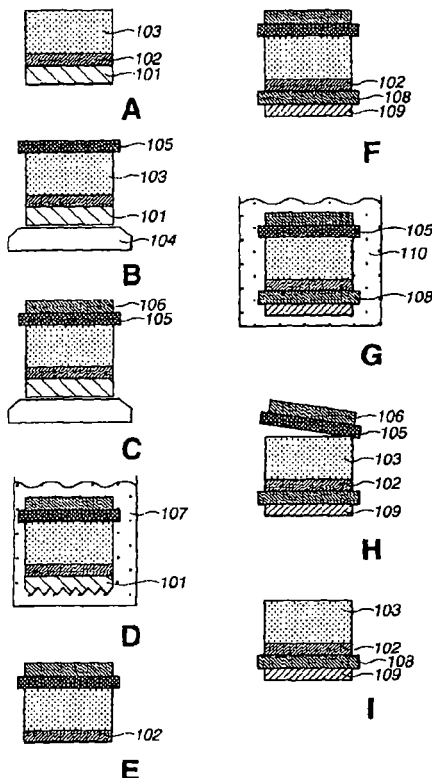
(10) 国際公開番号
WO 02/084739 A1

- (51) 国際特許分類⁷: H01L 27/12, 29/786, G02F 1/1368, G09F 9/30 (72) 発明者; および
(75) 発明者/出願人 (米国についてののみ): 浅野 明彦 (ASANO, Akihiko) [JP/JP]; 〒141-0001 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内 Tokyo (JP). 木下 智豊 (KINOSHITA, Tomoatsu) [JP/JP]; 〒141-0001 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内 Tokyo (JP).
- (21) 国際出願番号: PCT/JP02/03700
- (22) 国際出願日: 2002 年 4 月 12 日 (12.04.2002)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ: 特願2001-115119 2001 年 4 月 13 日 (13.04.2001) JP (74) 代理人: 小池 晃, 外(KOIKE, Akira et al.); 〒105-0001 東京都港区虎ノ門二丁目6番4号 第11森ビル Tokyo (JP).
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): ソニー株式会社 (SONY CORPORATION) [JP/JP]; 〒141-0001 東京都品川区北品川6丁目7番35号 Tokyo (JP). (81) 指定国 (国内): JP, KR, SG, US.
- 添付公開書類:
— 国際調査報告書

[続葉有]

(54) Title: THIN FILM-DEVICE MANUFACTURING METHOD, AND SEMICONDUCTOR DEVICE

(54) 発明の名称: 薄膜デバイスの製造方法及び半導体装置



(57) Abstract: A method of manufacturing a thin film-device, comprising the steps of sticking a second substrate (106) on a thin film-device layer (103) installed on a protective layer (102) formed on a first substrate (101) through a first adhesive layer (105), completely or partially removing the first substrate (101) by a process including at least one of a chemical processing and a mechanical polishing processing, sticking a third substrate (109) on the protective layer (102) covered with the exposed protective layer (102) or the partially removed first substrate (101) through a second adhesive layer (108), and separating or removing the second substrate (106), whereby the thin film-device suitable for a lightweight and thin display panel can be manufactured without impairing rigidity.



162162



ACTION

WO 02/084739 A1

[続葉有]